****

|  |  |
| --- | --- |
| **Leserkontakt:** | **Pressekontakt:** |
| **congatec AG** | **SAMS Network** |
| Christian Eder | Michael Hennen |
| Telefon: +49-991-2700-0 | Telefon: +49-2405-4526720 |
| [info@congatec.com](mailto:info@congatec.com)  [www.congatec.com](http://www.congatec.com) | [info@sams-network.com](mailto:info@sams-network.com)  [www.sams-network.com](http://www.sams-network.com) |



*Die Thin Mini-ITX Motherboards von congatec mit Intel® Core™ Prozessoren der siebten Generation*

*Text und Foto verfügbar:* [*http://www.congatec.com/presse*](http://www.congatec.com/presse)

Pressemitteilung

congatec launcht industriegerechtes Thin Mini-ITX Motherboard mit

Intel® Core™ U Prozessoren der siebten Generation für IoT angebundene Devices

**Besonders flach ausgelegte Motherboard Lösung**

**mit hohem Mehrwert!**

**Deggendorf, 7. März 2017 \* \* \*** congatec – ein führender Technologie-Anbieter für Embedded Computermodule, Single Board Computer und Embedded Design & Manufacturing Services – stellt mit dem conga-IC175 eine besonders flach ausgelegte, durchgängig industriegerechte Motherboard-Familie mit Intel® Core™ U Prozessoren der siebten Generation (Kaby Lake) für IoT angebundene Devices vor. Die neuen Boards sind die ideale Plattform für leistungsstarke Low-Power IoT-Designs bei begrenzten Platzverhältnissen. Neben allen Verbesserungen der neuen Prozessorgeneration überzeugen sie durch umfassenden IoT-Support inklusive SIM-Karten-Steckplatz für 3G / 4G oder Narrowband sowie die ersten Versionen der neuen congatec Cloud-API, die auf der Embedded World erstmals vorgestellt wird (Halle 1, Stand 358).

Die besonders flache Auslegung der neuen, durchgängig industrietauglichen Thin Mini-ITX Motherboard Familie von congatec eignet sich hervorragend für schlanke Systemdesigns wie industrielle GUIs/HMIs, Digital Signage Systeme, Point-of-Sales Terminals und Tablets für die Medizintechnik. Die Boards bestechen durch die Erweiterungsmöglichkeit eines mit dem ultraschnellen Intel® Optane™ Speichers auf dem M.2 Konnektor, der extrem schnelle Bootvorgänge, Applikationsstarts, Videoaufzeichnung und -verarbeitung sowie Softwareupdates erlaubt. Zudem unterstützen die Boards Hyperthreading, sodass das Dualcore-Design bei Verwendung des RTS Echtzeit-Hypervisors zu einem echten 4-in-1 System wird.

„Unsere neuen Thin Mini-ITX Motherboards können universell in allen Embedded- und IoT-Applikationen eingesetzt werden, da die neuen Low-Power Versionen der High-End 64 bit Intel® Core™ Prozessoren es durch ihre konfigurierbare TDP (Thermal Design Power) ermöglichen, die Wärmeabgabe zwischen 7,5 W und 25W cTDP frei zu skalieren. So lässt sich eine ideale Balance zwischen Leistungsaufnahme und Performance erzielen“, erklärt Martin Danzer, Director Product Management bei congatec. Das neue Flaggschiff-Design von congatec ist mit mindestens sieben Jahren Langzeitverfügbarkeit und einem umfangreichen Satz an industriegerechten Interfaces und Treibern perfekt auf Embedded und robuste Industriemärkte zugeschnitten. Dank des persönlichen Integrationssupports von congatec wird das Design-In zudem deutlich vereinfacht und so zu einer leichten Aufgabe für OEM Entwickler.

**Das Featureset in Detail**

Die neuen, durchweg industriegerecht ausgelegten conga-IC175 Thin Mini-ITX Motherboards sind mit vier verschiedenen Dualcore Varianten der Intel® Core™ U SoC Prozessoren der siebten Generation erhältlich und haben eine konfigurierbare cTDP von 7,5 W bis 25 W. Mit zwei SO-DIMM-Sockeln unterstützen sie bis zu 32 GB DDR4-2133 Speicher. Als nichtflüchtigen Speicher unterstützen die Boards über einen M.2 Sockel das neue Intel® Optane™ Memory für Massenspeicher mit signifikant niedrigeren Latenzen und höheren Datenraten. Über 2x SATA 3.0 können zusätzliche HDDs oder SSDs angebunden werden. Die neuen Boards binden über 2x DP++ sowie eDP oder Dual Channel LVDS bis zu drei unabhängige Displays in 4K Auflösung und 60 Hz an die DirectX 12 fähige Intel® HD Grafik 620 an. Die neue hardwarebeschleunigte 10 Bit En- und Dekodierung von HEVC und VP9 Videos entlastet die CPU und die HDR-Unterstützung macht Videos lebendiger und lebensechter. Das industriegerechte Schnittstellenangebot bietet 2x Gigabit Ethernet und einen SIM-Karten-Steckplatz für die M2M und IoT Anbindung über 3G/4G oder Narrowband, 1x PCIe x4 und 1x mPCIe für generische Erweiterungen sowie 4x USB 3.0, 6x USB 2.0, 8x GPIOs und 2x serielle COM Ports – wovon einer als ccTalk konfiguriert werden kann. Ein integrierter Board Management Controller, HDA Audio mit Stereoverstärker, ein MIPI CSI-2 Interface für den direkten Anschluss kostengünstiger CMOS Kameras sowie ein optionales TPM 2.0 Modul runden das Featureset ab. Die Boards unterstützen die 64 Bit Versionen von Microsoft Windows 10 und Windows 10 IoT sowie alle gängigen Linux Betriebssysteme. Ein umfangreiches Angebot an Zubehör – inkl. Kühllösungen, I/O-Blenden und Kabelsätzen – steht zum einfacheren Design-In ebenfalls zur Verfügung.

Die neuen conga-IC175 Thin Mini-ITX Boards können mit folgenden CPU Versionen geordert werden:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prozessor** |  | **Cores / Threads** |  | **Intel® Smart Cache [MB]** |  | **Clock / Burst**  **[GHz]** |  | **TDP / cTDP**  **[W]** |  | **Grafik** |
| **Intel® Core™ i7-7600U** |  | **2/4** |  | **4** |  | **2.8/3.9** |  | **15/7.5/25** |  | **Intel® HD Graphics 620** |
| **Intel® Core™ i5-7300U** |  | **2/4** |  | **3** |  | **2.6/3.5** |  | **15/7.5/25** |  | **Intel® HD Graphics 620** |
| **Intel® Core™ i3-7100U** |  | **2/4** |  | **3** |  | **2.4** |  | **15/7.5** |  | **Intel® HD Graphics 620** |
| **Intel® Celeron® 3965U** |  | **2/2** |  | **2** |  | **2.2** |  | **15/10** |  | **Intel® HD Graphics 610** |

Weitere Informationen zu den neuen industrietauglichen Thin Mini-ITX Boards finden Sie auf der Produktseite <http://www.congatec.com/de/produkte/mini-itx/conga-ic175.html>

**Über die congatec AG**

Mit Hauptsitz in Deggendorf, Deutschland ist die congatec AG ein führender Anbieter von industriellen Computermodulen auf den Standard-Formfaktoren COM Express, Qseven und SMARC sowie für Single Board Computer und EDM-Services. Die Produkte und Dienstleistungen des innovativen Unternehmens sind branchenunabhängig und werden z.B. in der Industrie-Automatisierung, der Medizintechnik, im Entertainment, im Transportwesen, bei Telekommunikation, Test & Measurement sowie Point-of-Sale Anwendungen eingesetzt. Wesentliche Kernkompetenz und technisches Know-How sind besondere, erweiterte BIOS Features sowie umfangreiche Treiberunterstützung und Board Support Packages. Die Kunden werden ab der Design-In Phase durch umfassendes Product Lifecycle Management betreut. Die Fertigung der Produkte erfolgt bei spezialisierten Dienstleistern nach modernsten Qualitätsstandards. congatec unterhält Niederlassungen in USA, Taiwan, China, Japan und Australien sowie in Großbritannien, Frankreich und Tschechien. Weitere Informationen finden Sie unter [www.congatec.de](http://www.congatec.de) oder bei [Facebook](http://www.facebook.com/Congatec), [Twitter](https://mobile.twitter.com/congatecAG) und [YouTube](http://www.youtube.com/congatecAE).

\* \* \*

*Intel, Intel Core, Celeron und Optane sind eingetragene Warenzeichen der Intel Corporation in den USA und anderen Ländern.*